

证券代码：301200

证券简称：大族数控

## 深圳市大族数控科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华夏未来资本（6月24日） 中金公司（6月25日、6月26日） 华安基金（6月25日） 招商基金（6月25日） 长江养老（6月26日） 阳光资管（6月26日） 南方基金（6月26日）
时间	2024年6月24日-6月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司上半年经营情况</b></p> <p>随着消费电子终端库存逐步消化，加上新能源汽车电子技术升级及 AI 服务器需求增加，下游客户的资本支出增长显著，公司 2024 年一季度营业收入同比增长 149.08%。目前公司订单有序交付中，上半年具体业绩情况请关注公司后续 2024 年半年度报告。</p> <p><b>二、公司所处行业情况及行业地位</b></p> <p>PCB 是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业，伴随着</p>

AI 产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长期来看整体延续增长态势；根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达 5%，并对行业的中长期维持积极展望，预估 2023-2028 年 PCB 行业营收复合增长率为 5.4%，其中 IC 封装基板、18 层以上多层板、HDI 保持较高的增速，但受全球经济波动的影响，PCB 产业依然存在投资支出年度不平均的情况，但整体规模持续保持正向增长态势。

公司深耕 PCB 行业 20 余年，通过不断创新业务发展模式，形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户的多维协同，市场地位持续保持领先，多年来屡次荣获行业知名上市企业“金牌供应商”、“优秀供应商”、“最佳设备合作伙伴”等荣誉奖项，与行业众多龙头客户形成良好的战略合作关系，成为客户端新场景、新项目研发的优先合作伙伴。

### 三、公司新产品的布局

2023 年，公司已完成压合系统、在线双面光学检查机等新产品的研发，进一步拓展了关键工序的覆盖，加上涂层刀具产品的引入，业务范围跨入真空压合设备、光学检测设备及材料领域，为公司开拓全流程一站式场景解决方案做有力铺垫。

另外，在已布局的工序及产品方面，公司持续推动跨越性升级，如十二轴机械钻孔机、四光束 CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、应用 AOD 技术的 UV 激光钻孔机、十六倍密通用高精测试机等，为 PCB 行业提供效率更高、综合成本更低的降本增效或提质增效解决方案，助力下游客户提升综合竞争力。

### 四、海外市场情况

PCB 制造企业海外布局进展加速，特别是泰国、越南等东南亚地区诸多项目进入设备评估阶段，公司积极拓展海外市场，推进海外公司设立，建立本土化的运营团队，及时满足客户的购机或技术支援需求。目前已与从中国大陆出海到东南亚国家的多家 PCB 企业达成合作意向，随着下游客户东南亚项目的陆续落地，公司海外市场的销售额有望显著增长。

### 五、公司的发展战略规划

一方面，公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值

	发现机制，不断拓宽公司产品矩阵，持续放大公司在该市场的价值；另一方面，公司聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，发挥多产品、多场景的协同优势，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 26 日